(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006 年1 月5 日 (05.01.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/001289 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/68, 21/301, 21/52

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/011408

(22) 国際出願日: 2005 年6 月22 日 (22.06.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-187518 2004 年6 月25 日 (25.06.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 辻本正樹 (TSUJIMOTO, Masaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 吉岡孝久 (YOSHIOKA, Takahisa) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小林賢治 (KOBAYASHI, Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

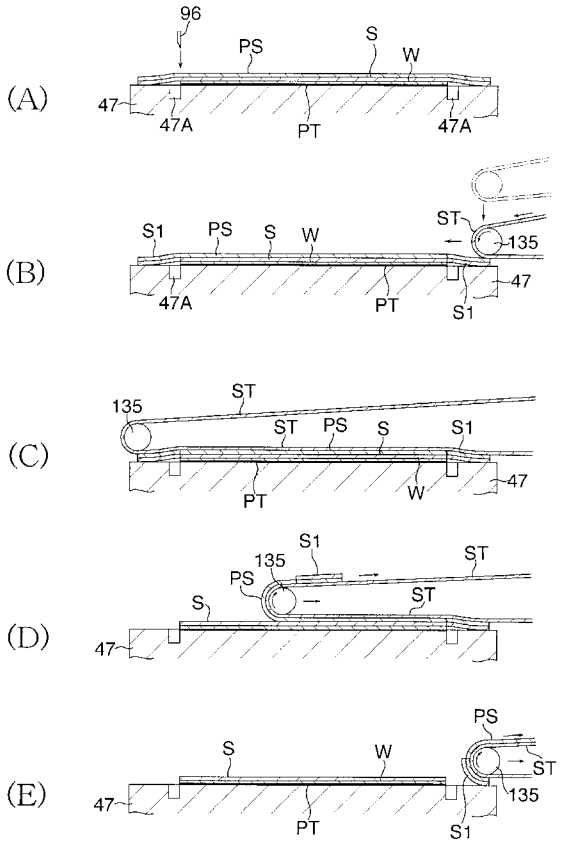
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

/続葉有/

(54) Title: SHEET PEELING DEVICE AND METHOD

(54) 発明の名称: シート剥離装置及び剥離方法



(57) Abstract: A sheet peeling device (50) sticks a sheet of a master roll (LS), produced by laminating a heat-sensitive adhesive sheet (S) to a peeling sheet (PS), to a semiconductor wafer (W), and then cuts the master roll sheet along the outer circumference of the semiconductor wafer to peel off a part of the peeling sheet (PS) located on the semiconductor wafer and the master roll sheet part (S1) located on the outer circumferential side around the semiconductor wafer. The sheet peeling device (50) comprises a roll (135) capable of moving relatively to a table (47) supporting the wafer (W). A strip tape (ST) is stuck to the master roll sheet (LS) by means of the roll (135) and then taken up and stripped to leave only the adhesive sheet (S) on the wafer (W).

(57) 要約: 剥離シートＰＳに感熱接着性の接着シートＳが積層された原反ＬＳを半導体ウエハＷに貼付した後に、半導体ウエハの外周に沿って原反を切断し、半導体ウエハ上に位置する剥離シートＰＳ部分と半導体ウエハ回りの外周側に位置する原反部分Ｓ１を剥離するシート剥離装置５０。同装置は、ウエハＷを支持するテーブル４７に対して相対移動可能なロール１３５を備えており、当該ロールによって剥離テープＳＴを原反ＬＳに貼付し、その後に巻き取って剥離することで、ウエハＷに接着シートＳのみを残すようになっている。

WO 2006/001289 A1

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。